



# 58451

## 제품 정보

30µm 블랙 전기 전도성(XYZ) 반응성 HAF 마운팅 테이프

### 제품 설명

tesa HAF® 58451은 전기 전도성을 지닌 페놀 수지와 니트릴 고무를 기반으로 한 반응성 열 활성화 필름입니다. 이 블랙 양면 테이프에는 기재가 없습니다. 50µm PET 라이너로 보호됩니다.

실은에서 tesa HAF® 58451은 끈적거리지 않습니다. 조립 과정에서 가해지는 열과 압력에 의해 활성화됩니다.

#### 특징:

- 작은 본딩 영역과 얇은 디자인 간격에서도 매우 높은 성능
- XYZ 방향의 탁월한 전기 전도성
- 상승된 온도에서도 탁월한 반발 방지 특성
- 뛰어난 내화학성

### Applications

tesa HAF® 58451은 특히 SUS 또는 AL과 같은 다양한 금속 표면의 본딩에 권장됩니다.

- 구조적 본딩 요구 사항이 있는 접지 애플리케이션
- 좁고 작은 본딩 영역이지만 여전히 매우 강력한 본딩 강도가 필요한 경우
- 곡선형 또는 구부러진 본딩과 같은 높은 반발력이 필요한 애플리케이션
- 높은 온도와 습도에 노출되는 접지 애플리케이션

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### 제품 구조

• 기재 소재	없음	• 총두께	30 µm
• 접착제 종류	니트릴고무 / 페놀수지	• 컬러	검정
• 이형지 종류	PET		

#### 속성 / 성능 값

• z-축 방향 접촉저항 (2kg)	50 mOhm	• 표면 저항 x-y-축 방향	500 mOhm
• 접착력 (동적 전단)	5 N/mm <sup>2</sup>		



# 58451

## 제품 정보

### 추가정보

기술 권장 사항: tesa HAF® 58451은 자가점착성이 없습니다. 일정 간격 동안 열과 압력에 의해 활성화됩니다. 다음 값은 시작 시 본드 라인 파라미터에 대한 권장 사항입니다.

1. 사전 라미네이션: 사전 라미네이션 중에 테이프가 하나의 부품에 라미네이팅됩니다.

설정:

- 온도<sup>1</sup> ≥120°C
- 압력<sup>2</sup> ≥5bar
- 시간 5~10초

2. 본딩: 사전 라미네이션 단계 후에 테이프에서 라이너를 제거합니다. 본딩할 기관 위에 사전 라미네이팅된 부품을 놓습니다. 충분한 본딩 강도에 도달하려면 본딩 시간 동안 압력을 가하면서 충분한 온도를 적용합니다.

설정:

- 온도<sup>1</sup> 120~250°C
- 압력<sup>2</sup> 5~30bar
- 시간 5초~3분

<sup>1</sup> '사전 라미네이션' 및 '본딩' 온도는 본딩 라인에서 측정된 데이터를 나타냅니다. <sup>2</sup> '사전 라미네이션' 및 '본딩' 압력은 지그 표면에서 본딩 영역으로 직접 변환되는 힘을 나타냅니다. 본딩 강도 값은 표준 실험실 조건에서 입수되었습니다. (재질: SUS 시험편 / 본딩 조건: 온도 = 180°C, 압력 = 30bar, 시간 = 30초). 최대 본딩 강도에 도달하려면 표면이 깨끗하고 건조해야 합니다.

## 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=58451>